

[会員限定] 2025年度第4回 先端半導体パッケージWG研究会

【会場】大阪大学産業科学研究所
インキュベーション棟1階 講義室 (I-117)

2025年

受付13:00~

11/26 (水) 13:30~18:00

13:30-13:35

開会挨拶 菅沼克昭 所長・特任教授 大阪大学産業科学研究所F3D実装協働研究所

13:35-14:35

AI時代のチップレットインターコネクト技術



講師：堀部晃啓氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所
セミコンダクターチップレット インターコネクト 部長

ハイブリッド

AI需要の急増に伴い、コンピューターシステムの性能向上のニーズがますます拡大している。CPUとメモリーの性能向上に合わせて、それらチップレット間のインターコネクト性能が全体性能向上のキモとなる。今回はインターコネクト技術の中でも特に注目を集めているシリコンブリッジ技術と光インターフェース技術の現状とその信頼性について議論する。

14:35-15:35

先進パッケージ製品開発における製造課題への取組 — モデルと材料情報の利活用の可能性



講師：坪井一正氏 アンシス・ジャパン 株式会社 Director Application
Engineering - N&ET Pre-Sales Support

ハイブリッド

先進パッケージ製品開発において、製造の歩留まり改善は重要なビジネス課題であり、課題解決の手段としてシミュレーション技術を使ったモデル利用が進んでいます。同時に、設計・製造プロセスに関わるモデルには適切な材料情報が必要であり、多様な関係者間でモデルと材料情報を利活用するプラットフォームが重要な役割を果たします。本発表では、シミュレーション技術の製造プロセスへの課題解決の適用例に加えて、材料プラットフォーム利用の可能性について紹介します。

15:35-15:45 休憩・講師との名刺交換会

15:45-16:45

エネルギーの場、コンピューターのカタチ



講師：三浦典之氏 大阪大学大学院情報科学研究科 教授

ハイブリッド

コンピューターのカタチは、エネルギー場のカタチによって決まる。本講演では、超小型粉末バッテリーから発生する近接磁場を利用して動作する粉末コンピューターや、半導体製造中のプラズマから動作エネルギーを獲得する胎動コンピューターなどの新しいカタチのコンピューターを議論する。

17:00-18:00 講師を交えた意見交換会